

TLE-95

AGC

Your Dreams, Our Challenge

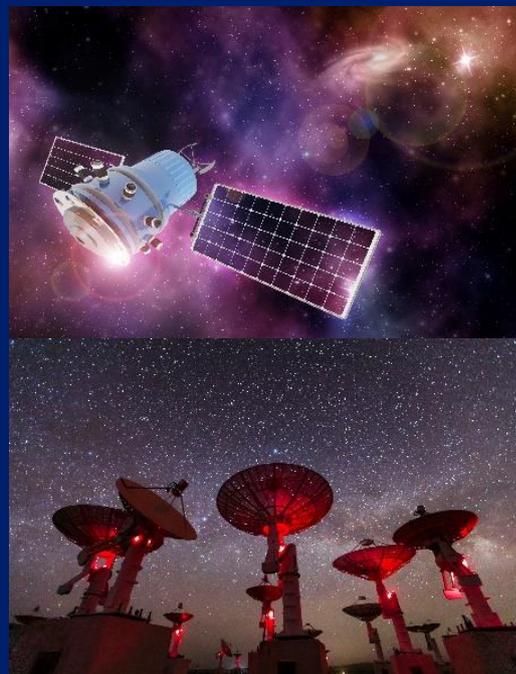
耦合器专用薄型介电基材

Benefits

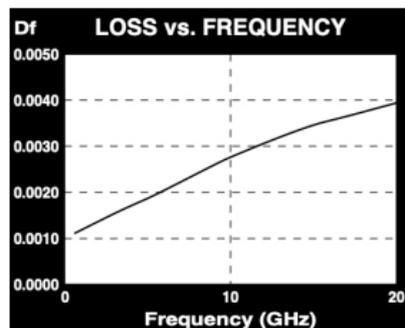
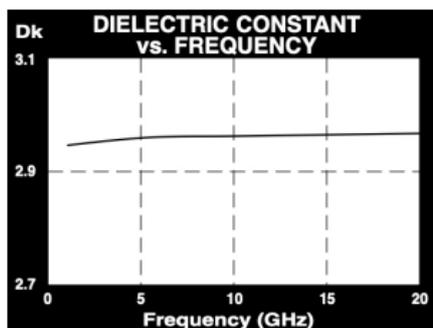
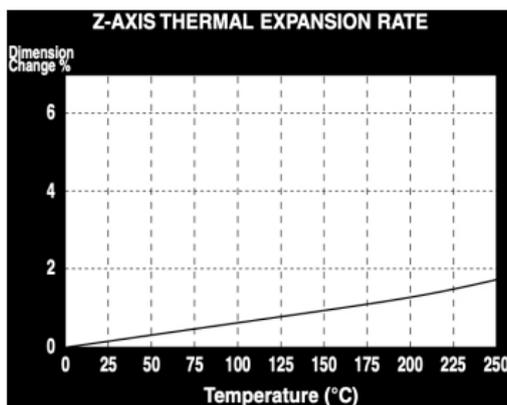
- 低 CTE 值
- 稳定的尺寸稳定性
- 低损耗因数
- 低且稳定的介电常数
- 高抗弯强度
- UL 94 V-0 等级

Applications

- 微波无线电
- 卫星天线系统
- 无源组件



TLE-95 层压板的设计制造旨在提供可满足复杂的微波和高速数字应用要求的电气和机械性能。低 Z 轴 CTE 提供了绝佳的内孔电镀通孔可靠性，而 X 和 Y 平面的低热膨胀属性则确保了表面贴装应用的高可靠性。Dk 在温度上的变化最小。TLE-95 通常以 $2.95 \text{ DK} \pm 0.05$ 提供。TLE-95 层压板尺寸稳定，在加工过程中几乎未表现出任何水分吸收率，通常在单侧或双侧包覆 0.5, 1 和 2 盎司电沉积铜。TLE-95 层压板的易燃性为 V-0，并根据 IPC-TM 650 进行试验。每批货物均随附一份包含试验数据的合格证书。



属性	条件	典型值	单位	试验方法
电气性能				
介电常数	@ 10 GHz	2.95 ± 0.05		IPC-650 2.5.5.5
损耗因数	@ 10 GHz	0.0026		IPC-650 2.5.5.5
体积电阻率		10 ⁷	Mohms/cm	IPC-650 2.5.17.1
表面电阻率		10 ⁷	Mohms	IPC-650 2.5.17.1
热性能				
导热系数		0.20	W/M*K	ASTM F 433
CTE (50°C ~ 150°C)	X	9	ppm/°C	ASTM D 3386 (TMA)
	Y	12		ASTM D 3386 (TMA)
	Z	70		IPC-650 2.4.41 / ASTM D 3386
机械性能				
介电强度	ASTM D 149	16,800 (427)	V/mm (V/mil)	IPC-650 2.4.8
剥离强度	1 oz. copper	>2.1 (12)	N/mm (lbs/in)	IPC-650 2.4.8
抗弯强度	MD	>241 (35,000)	N/mm ² (lbs/in)	IPC-650 2.4.4
	CD	>207 (30,000)	N/mm ² (lbs/in)	
物理/化学性能				
吸水率		<0.02	%	IPC-650 2.6.2.1
介电击穿		>60	Kv	IPC-650 2.5.6
电弧电阻		>180	Seconds	IPC-650 2.5.1
易燃性等级			V-0	UL-94

典型厚度

Inches	mm
0.0052	0.13
0.0100 - 0.0190	0.25 - 0.48
0.0200 - 0.0300	0.50 - 0.76
≥ 0.0310	≥ 0.80

可用的板材尺寸

Inches	mm
12 x 18	305 x 457
16 x 18	406 x 457
18 x 24	457 x 610
16 x 36	406 x 914
24 x 36	610 x 914
18 x 48	457 x 1,220

* 提供的所有试验数据均为典型值，并非规范值。如需查看关键规格公差，请直接联系公司代表。

* TLE-95可按 0.010 英寸(0.250 毫米)的增量制造。

* 标准面板尺寸为 18 英寸 x 24 英寸(457 毫米 x 610 毫米)。

* 有关其他厚度，其他尺寸和任何其他类型的覆层的可用性，请联系 AGC。

